

第4回 サイエンス・サロン ～次世代グリーンパワー技術における最先端研究～

セッション3 2023年3月23日(木)
10:00～17:30

10:00～10:45		東京大学 大学院工学系研究科電気系工学専攻 高木 信一 教授	講演1 「低電力メモリ応用を目指した HZO 系強誘電体デバイス」
10:45～11:30		東北大学 大学院工学研究科 金森 義明 教授	講演2 「カーボンニュートラル×Beyond5G/6G に向けたメタマテリアル」
11:30～12:15		中央大学 理工学部 鈴木 教和 教授	講演3 「次世代 CMP のための先進シミュレーション技術」
12:15～14:00		昼休憩	
14:00～14:45		東北大学 国際集積エレクトロニクス研究開発センター 高橋 良和 教授	講演4 「WBG デバイスを用いた次世代パワーモジュール / ユニット技術」
14:45～15:30		高知工科大学 環境理工学群 古田 守 教授	講演5 「酸化物半導体薄膜トランジスタの現状と将来展望」
15:30～16:00		休憩	
16:00～16:45		奈良先端科学技術大学院大学 物質創成科学研究科 浦岡 行治 教授	講演6 「金属酸化物薄膜トランジスタの劣化現象と高信頼性化技術」
16:45～17:30		明星大学 須賀 唯知 教授	講演7 「表面活性化接合の常温ヘテロインテグレーションへの適用」

主催：株式会社キャンパスクリエイト

<https://www.campuscreate.com/>